

**株主の皆さまへ**

**第 30 期 報 告 書**

2007年4月1日から2008年3月31日まで



## 株主の皆さまへ

### ご挨拶

株主の皆さまには、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした堅調な設備投資やアジア諸国を中心とした輸出の増加等により前半においては、景気回復基調で推移しました。しかしながら後半は、原油をはじめとした資源価格の高騰や米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮など、景気の先行きに対する不透明感が急速に強まりました。

また、半導体業界においては、デジタル家電市場やBRICs諸国等の新興国を中心とした最終製品需要の拡大から、半導体の生産量はおおむね好調に推移したものの、メモリー製品を中心とした企業間競争の激化により、半導体価格は大幅な下落が進みました。

このような状況のもと、当連結会計年度の連結業績は、台湾アセンブリハウスの中国進出が本格的になったことからモールドング装置が好調に推移したことに加え2006年4月にスタートしました中期経営計画「Challenge30」に掲げた諸施策の進捗に伴う収益力の改善により、大幅な増益を達成いたしました。

こうした経営環境を背景に、当社は株主の皆さまへの利益還元を実現することを重要施策の一つと認識し、当期の期末配当金につきましては、1株当たり10円とさせていただきます。

当社グループといたしましては、いかなる環境下においても利益を生み出す強い企業体質の定着を目指し、株主の皆さまのご期待に報いるべく、グループ一丸となって不断の構造改革を邁進していく所存でございます。

今後とも、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2008年6月



代表取締役会長

代表取締役社長

坂本和彦 河原洋逸

### 概況と今後の見通し

当社グループは、現代社会において不可欠な存在である半導体の更なる進化に対応し、産業界が求める「技術開発」を根幹にした事業展開を行うことで、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」を市場に提供することを基本方針としております。

### 中期経営計画、基礎固めの2年目—新基幹システムスタート。

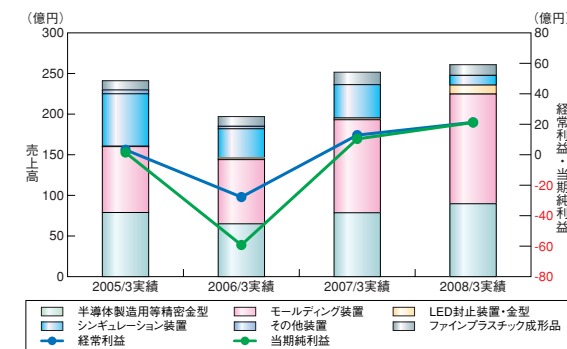
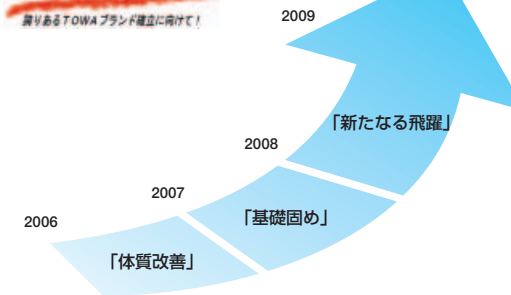
中期経営計画「Challenge30」の中核となる、業務合理化を目的とした新基幹システムが、2008年4月、当社で本格始動いたしました。この統合業務パッケージ（ERP）の導入によって、生産や販売、在庫、購買、物流、会計など、TOWA社内あらゆる経営情報を一元管理し、共有・活用することができるようになりました。業務の効率化、お客様のニーズへのより迅速で、よりの確な対応を図るため、今後TOWAグループ全体への展開を進めていく予定です。

また生産キャパアップやリードタイム短縮などの生産体制の整備を進め、シンガポールの金型工場閉鎖や、米国子会社のリストラによる固定費削減などに取り組んでまいりました。

「基礎固めの年」と位置付けた2008年3月期は、これら中期経営計画諸施策の進捗に伴う収益改善により、売上高257億53百万円（前年同期比5億93百万円、2.4%増）、経常利益21億25百万円（同8億36百万円、64.8%増）、当期純利益21億18百万円（同10億80百万円、104.0%増）を計上することができました。



### Challenge 30



## 新方式採用のLED用樹脂封止装置—独自技術の結集と新たなチャレンジ。



当社の原点は「モノづくり」であります。創業以来、半導体業界において省資源化、高品質、高性能を実現してきた当社の技術は、「金型関連技術」として、そのノウハウを蓄積してまいりました。これは今現在も当社のコア・コンピタンスであり、当社グループが市場から高い信頼を得ている根源であります。

このコア・コンピタンスを軸に据え、当社グループは技術革新の著しい半導体業界において、半導体パッケージングというフィールドで最先端の技術を開発し、半導体メーカー各社が半導体の薄型化、微細化等を実現するための一助となってまいりました。これは皆さまが日常お使いになられる最終製品の薄型化・小型化や高性能化に大きな貢献を果たして来たものと自負しております。

また、多様化する高度なニーズに的確にお応えすることで、当社の技術は半導体業界にとどまらず、周辺業界のベストソリューションとしても採用されるようになりました。中でも、コンプレッション方式によるモールドディング技術

を新たに開発し、LED樹脂封止工程に革新的な生産手法を提案いたしました。これにより、現在多くのLEDメーカーから引き合いをいただいております。この「LED用樹脂封止装置」の複数プレス量産機を投入することで、今後ますます市場規模拡大が見込まれるLED分野の事業規模拡大を本格的に進めてまいります。

## 増産体制の確立

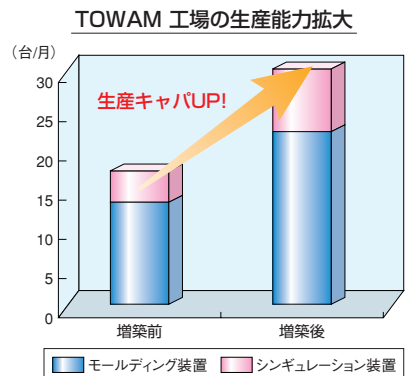
LED市場をはじめとする成長分野へのコア・コンピタンスの展開による新事業領域の開拓に加え、生産体制については、国内外の工場稼働率の向上に取り組んでまいりました。

九州事業所は工場を拡張し金型生産能力を増強、海外主力生産工場であるTOWAM Sdn.Bhdは、装置増産と設計業務効率化の実現を図る体制を構築するため、増築いたしました。

この増築効果により、装置部品の内製化率が2.5～3倍に改善され、装置本体に関わる組立作業もすべて内製化が可能となりました。生産能力も従来比2倍へ高めるとともにユーザーへの直接出荷体制を拡充し物流コストを低減、リードタイム短縮と品質の均一化が進展いたしました。

また、シンギュレーション装置は、その生産拠点を米国から日本国内に移すとともに、設計を日本仕様へと抜本的に見直し、市場競争力のある価格および品質を実現いたしました。

当社は、市場環境や拠点国の経済、政治情勢に応じて最適な生産体制、販売体制を選択することで、固定費削減、物流コストの低減、リードタイムの短縮を実現し、QCD (Quality 品質, Cost 価格, Delivery 納期) の最適化を進めてまいります。



## 飛躍！誇りあるTOWAブランド確立に向けて。

当社グループをとりまく半導体業界は世界経済の不安定化の影響を受け半導体市場においても調整感が見られますものの、生産性向上に向けた設備投資は引き続き継続されるものと予想しております。特に半導体材料の高騰が続く中、当社が開発したコンプレッションモールド方式での生産コスト削減効果に注目が集まっております。また、LED市場についても液晶テレビやノートパソコンのバックライト用途が急速に立ち上がりつつあり、当社製品がLEDの生産において大きく貢献できるものと確信しております。

このような環境下、当社グループは、2006年4月にスタートした中期経営計画の最終年度を迎えます。足許の半導体市況を勘案し、売上高は300億円から240億円に修正いたしました。経常利益率については、目標数値である10%を達成するべく取り組んでおります。今後も、市場変化に即応できる生産体制の確立を図ることによって、モールドディング装置・金型市場シェア50%以上を獲得し、シンギュレーション事業とLED分野への注力により、中期経営計画の達成を目指してまいります。

「飛躍の年」と位置付けた中期経営計画3年目の2009年、当社は創立30周年を迎えます。中期経営計画の最終目標達成に向け、TOWAグループ全社一丸となって経営目標の達成を目指してまいります。



## 個人投資家向けIR会社説明会を開催

2007年11月に京都で開催された東京IPO主催の個人投資家向けIR説明会に当社も参加いたしました。地元を中心とした個人投資家の皆さまに「京都の企業であるTOWA」の、他社とは一線を画す技術の進歩や半導体製造工程における当社の重要性をご説明し、「京都発→世界へ」のキーワードと共に、当社の事業内容や企業文化を感じていただくことができました。



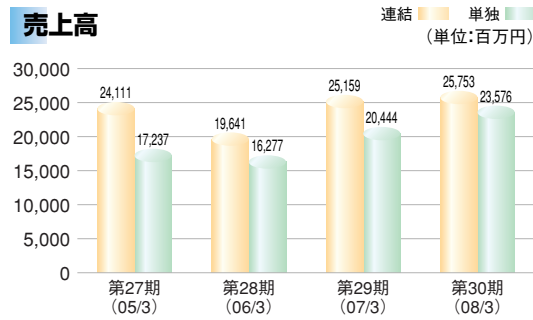
## ブルームバーグテレビジョンに出演

国内で最も権威ある経済ニュースチャンネルとして高く評価されているテレビ局、ブルームバーグテレビジョン。その中でも、市場関係者や投資家の皆さまから多くの支持を集めている番組「ブルームバーグボイス」に社長の河原が出演し、当社の中長期経営計画・業界環境・業績についてご説明いたしました。

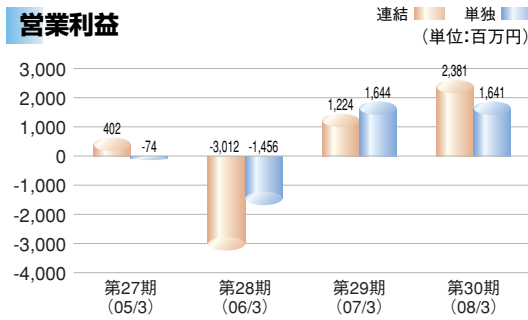
多くの皆さまにTOWAファンになっていただけるよう、今後もさまざまな活動を展開してまいります。

# 業績の推移

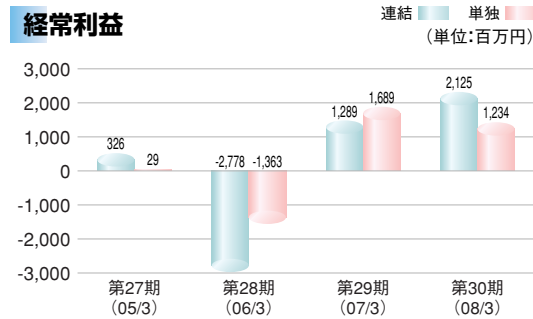
## 売上高



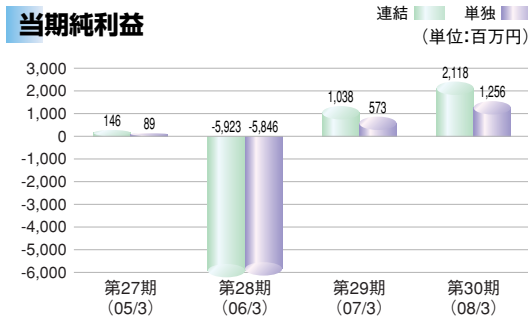
## 営業利益



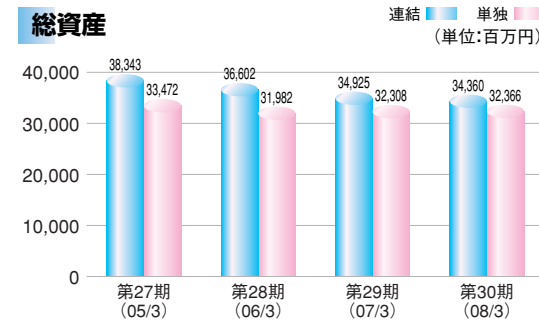
## 経常利益



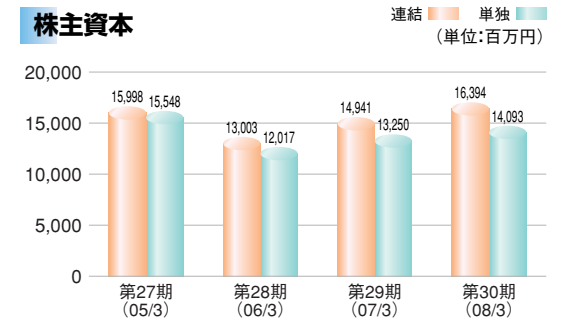
## 当期純利益



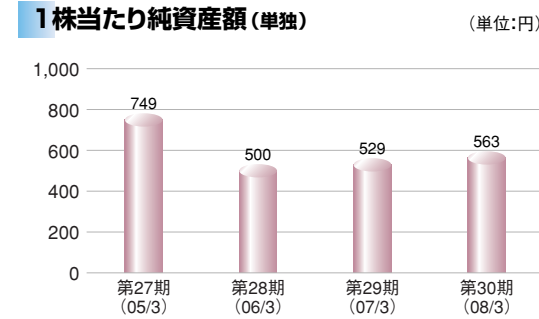
## 総資産



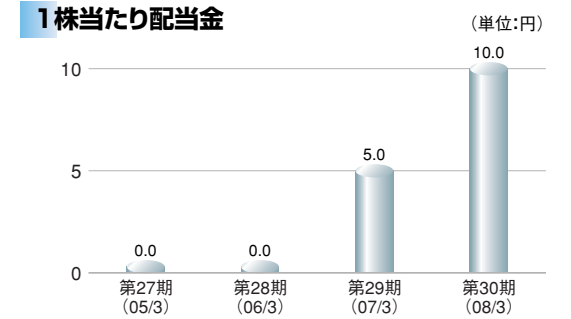
## 株主資本



## 1株当たり純資産額 (単独)

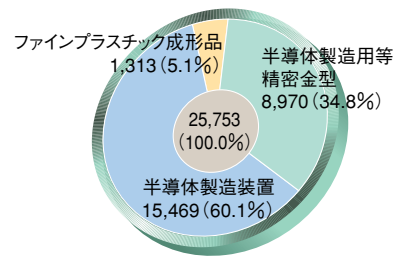


## 1株当たり配当金

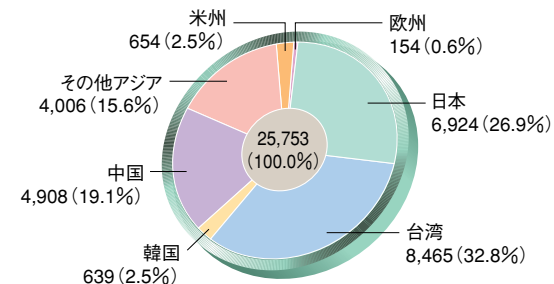


## [セグメント別連結売上高 (第30期)]

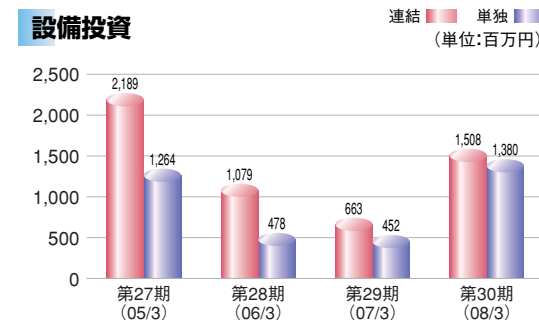
### ■製品別 (単位:百万円)



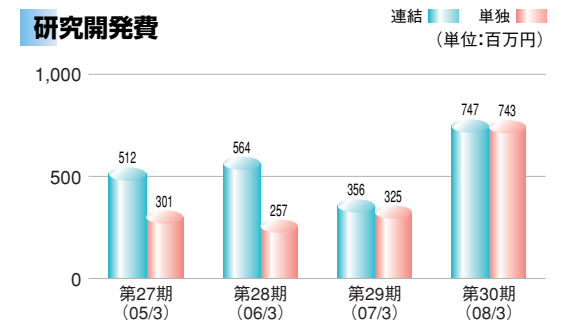
### ■地域別 (単位:百万円)



## 設備投資



## 研究開発費



業績の推移

# 決算概要

連結貸借対照表 (2008年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	17,650
現金および預金	3,351
受取手形および売掛金	9,871
たな卸資産	4,052
その他	375
固定資産	16,710
有形固定資産	11,932
建物および構築物	4,945
土地	4,528
その他	2,458
無形固定資産	1,153
投資その他の資産	3,624
資産合計	34,360

(注) 当期の連結子会社は12社、持分法適用会社は4社であります。

連結損益計算書

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
売上高	25,753
売上原価	18,220
売上総利益	7,533
販売費および一般管理費	5,152
営業利益	2,381
営業外収益	567
営業外費用	822
経常利益	2,125
特別利益	169
特別損失	130
税金等調整前当期純利益	2,164
法人税、住民税および事業税	60
法人税等調整額	△ 14
当期純利益	2,118

科目	金額
<b>【負債および純資産の部】</b>	
流動負債	12,843
支払手形および買掛金	2,931
短期借入金	5,273
その他	4,638
固定負債	5,121
長期借入金	3,025
その他	2,096
負債合計	17,965
株主資本	15,961
資本金	8,932
資本剰余金	3,115
利益剰余金	3,921
自己株式	△ 7
評価・換算差額等	432
その他有価証券評価差額金	333
為替換算調整勘定	99
純資産合計	16,394
負債・純資産合計	34,360

連結株主資本等変動計算書 (2007年4月1日から2008年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2007年3月31日 残高	8,932	3,115	1,927	△ 6	13,969
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 125		△ 125
当期純利益			2,118		2,118
自己株式の取得				△ 1	△ 1
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,993	△ 1	1,992
2008年3月31日 残高	8,932	3,115	3,921	△ 7	15,961

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
2007年3月31日 残高	621	350	971	14,941
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 125
当期純利益				2,118
自己株式の取得				△ 1
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△ 287	△ 251	△ 539	△ 539
連結会計年度中の変動額合計	△ 287	△ 251	△ 539	1,453
2008年3月31日 残高	333	99	432	16,394

## 会社の概要

商号 TOWA株式会社  
(英文名TOWA CORPORATION)  
設立 1979年4月17日  
資本金 8,932,627,777円  
本社所在地 京都市南区上鳥羽上調子町5番地  
☎ (075) 692-0250 (代表)  
従業員数 455名  
役員  
(2008年6月27日現在)  
代表取締役会長 坂 東 和 彦  
代表取締役社長 河 原 洋 逸  
取締役専務執行役員 西 村 永 和  
取締役常務執行役員 岡 田 博 和  
取締役執行役員 福 富 誠 司  
取締役執行役員 大 崎 清 司  
執行役員 岩 下 昌 生  
執行役員 小 西 久 二  
常勤監査役 白 山 勉  
監査役 杉 山 公 律  
監査役 梅 山 克 啓  
ホームページ <http://www.towajapan.co.jp>



当社ホームページに詳細情報を掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。  
TOWAへのご理解をさらに深めていただくために、最新情報をお届けしております。

## 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年  
定時株主総会 毎年6月  
基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日  
中間配当 9月30日  
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
みずほ信託銀行株式会社  
同事務取扱場所 大阪市北区曽根崎二丁目11番16号  
みずほ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部  
郵便物の郵送先 〒135-8722東京都江東区佐賀一丁目17番7号  
および連絡先 みずほ信託銀行株式会社証券代行部  
☎0120-288-324 (フリーダイヤル)  
同取次所 みずほ信託銀行株式会社本店および全国各支店  
みずほインバスターズ証券株式会社本店および全国各支店  
単元株式数 100株  
公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。  
公告掲載URL (http://www.towajapan.co.jp)  
上場取引所 東京証券取引所市場第一部  
大阪証券取引所市場第一部

## 株式の状況

(2008年3月31日現在)

●発行可能株式総数 80,000,000株  
●発行済株式の総数 25,021,832株  
●株主数 8,427名  
●大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	出資比率
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	2,552	10.2%
坂 東 和 彦	2,091	8.4%
(有) ケ イ ビ ー 恒 産	2,000	8.0%
資産管理サービス信託銀行(株)	1,525	6.1%
日本マスタートラスト信託銀行(株)	1,063	4.3%
ザ チェース マンハッタンバンク エヌ エイ ロンドン エス エル オムニバス アカウ ント(株)	755	3.0%
京 都 銀 行	699	2.8%
山 田 矩 規 子	501	2.0%
(有) ケ イ ビ ー テ ク ノ	500	2.0%
バンクオブニューヨーク・ジェシー クライアントアカウント ジェイビーアールディ アイエス ジー エフイー エイシー	384	1.5%

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)および資産管理サービス信託銀行(株)の持株数は、下記株主名義の所有株式数の合計をもって表示しております。  
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 2,377,400株  
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口4) 175,200株  
資産管理サービス信託銀行(株) (証券投資信託口) 795,200株  
資産管理サービス信託銀行(株) (年金特金口) 427,000株  
資産管理サービス信託銀行(株) (信託A口) 124,900株  
資産管理サービス信託銀行(株) (信託Y口) 117,100株  
資産管理サービス信託銀行(株) (年金信託口) 33,800株  
資産管理サービス信託銀行(株) (金銭信託課税口) 27,100株

## TOWAグループ

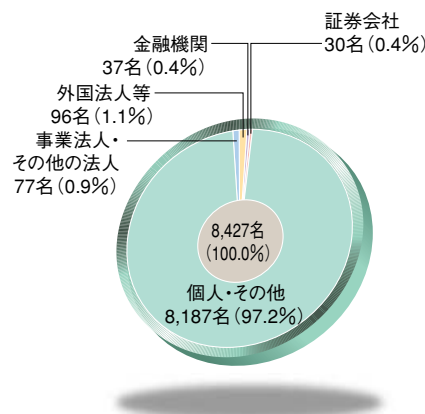
### 国内

TOWA株式会社  
本社・工場  
京都東事業所  
坂東記念研究所榎島分室  
九州事業所  
東京営業所  
株式会社バンディック  
TOWATEC 株式会社  
TOWAサービス株式会社  
株式会社サーク

### 海外

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corporation (フィリピン)  
TOWA-Intercon Technology, Inc. (米国)  
TOWA Europe GmbH (ドイツ)  
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)  
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)  
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)  
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)  
巨東精技股份有限公司 (台湾)  
SECRON Co., Ltd. (韓国)  
株式会社東進 (韓国)

### 所有者別株主数分布



### 所有者別株式数分布

